



# 智晶光電股份有限公司

## 資金貸與他人作業管理辦法

### 第一條：訂定依據及目的

本公司若因業務需要，需將資金貸與其他公司(以下簡稱借款人)，均需依照本作業管理辦法辦理。本辦法如有未盡事宜，另依相關法令之規定辦理。

### 第二條：資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額

一、依公司法第十五條規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：

(一)與本公司有業務往來之公司或行號；前述所稱「業務往來」係指與本公司有進貨或銷貨行為者。

(二)與本公司有短期融通資金必要之公司或行號；「短期」，依經濟部前揭函釋，係指一年或一營業週期(以較長者為準)之期間。融資金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。

(三)本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與時，其金額得不受第一項第二款之限制。但仍應依第二條第二款及第三條規定訂定資金貸與之限額及期限。

(四)公司負責人違反第二條之規定時，應與借用人連帶負返還責任；如公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。

### 二、資金貸與總額及個別對象之限額

(一)資金貸與有業務往來公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值百分之四十為限；而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

(二)資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，該貸與總金額以不超過本公司淨值百分之四十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。

### 第三條：資金貸與期限及計息方式

一、每次資金貸與期限自放款日起，以不超過一年或一營業週期(以較長者為準)為原則，惟經董事會決議通過者，得延期一次(一年)。

二、貸放資金之利息計算，係採按日計息，以每日放款餘額之和(即總積數)先乘其年利率，再除以365天，再乘上借款天數為利息金額。年利率不得低於本公司平均之銀行短期借款利率為原則。

三、放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次為原則，於約定繳息日前一週通知借款人按時繳息。

### 第四條：審查程序

#### 一、申請程序

(一)借款者應提供基本資料及財務資料，並填具申請書，敘述資金用途，借款期間及金額後，送交本公司財會部門。

本資料內容為智晶光電專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用。

The content of document is the exclusive property of WiseChip Semiconductor Inc. and shall not be distributed or reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of WiseChip Semiconductor Inc.



(二)若因業務往來關係從事資金貸與，本公司財會部門經辦人員應評估貸與金額與業務往來金額是否相當；若因短期融通資金之必要者，應列舉得貸與資金之原因及情形，並加以徵信調查，將相關資料及擬具之貸放條件呈報董事會決議。但重大之資金貸與，應依相關規定經審計委員會同意，並提董事會決議。

## 二、徵信調查

- (一)初次借款者，借款人應提供基本資料及財務資料，以便辦理徵信工作。
- (二)若屬繼續借款者，原則上於提出續借時重新辦理徵信調查，如為重大或緊急事件，則視實際需要隨時辦理。
- (三)若借款人財務狀況良好，且年度財務報表已委請會計師辦妥融資簽證，則得沿用尚未超過一年之調查報告，併同該期之會計師查核簽證報告，以作為貸放之參考。
- (四)本公司對借款人作徵信調查時，亦應一併評估資金貸與對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

## 三、貸款核定及通知

- (一)經徵信調查及評估後，董事會決議不擬貸放案件，經辦人員應將婉拒理由儘速回覆借款人。
- (二)經徵信調查及評估後，董事會決議同意貸放案件，經辦人員應儘速函告借款人，詳述本公司放款條件，包括額度、期限、利率、擔保品及保證人等，請借款人於期限內辦妥簽約手續。

## 四、簽約對保

- (一)貸放案件應由經辦人員擬定約據條款，經主管人員審核並送請法律顧問會核後再辦理簽約手續。
- (二)約據內容應與核定之借款條件相符，借款人及連帶保證人於約據上簽章後，應由經辦人員辦妥對保手續。

## 五、擔保品價值評估及權利設定

貸放案件如有擔保品者，借款人應提供擔保品，並辦妥質權或抵押權設定手續，本公司亦需評估擔保品價值，以確保本公司債權。

## 六、保險

- (一)擔保品中除土地及有價證券外，均應投保火險及相關保險，保險金額以不低於擔保品質押為原則，保險單應註明以本公司為受益人。保單上所載標的物名稱，數量、存放地點、保險條件、保險批單等應與本公司原核貸條件相符。
- (二)經辦人員應注意在保險期限屆滿前，通知借款人續投保。

## 七、撥款

貸放條件經核准並經借款人簽妥合約，辦妥擔保品質(抵)押設定登記等，全部手續核對無誤後，即可撥款。

## 第五條：還款

貸款撥放後，應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，在放款到期一個月前，應通知借款人屆期清償本息。



- 一、借款人於貸款到期償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償後，公司始得將本票、借據等債憑證註銷發還借款人。
- 二、如借款人申請塗銷抵押權時，應先查明有無借款餘額後，以決定是否同意辦理抵押塗銷。

#### 第六條：展期

借款人於貸放款到期前，如有需要，應於借款到期日前一個月申請展期續約，並以一次(一年)為限，本公司應於重新徵信及評估担保品價值(若有提供担保者)後，並提報董事會決議通過後，重新辦理相關手續。

#### 第七條：案件之登記與保管

- 一、公司辦理資金貸與事項，應建立資金貸與明細表，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依本辦法應審慎評估之事項詳予登載備查。
- 二、貸放案件經辦人員對本身經辦之案件，於撥貸後，應將約據、本票等債權憑證、以及擔保品證件、保險單、往來文件，依序整理後，裝入保管品袋，並於袋上註明保管品內容及客戶名稱後，呈請財會部門單位主管檢驗，俟檢驗無誤即行密封，雙方並於保管品登記簿簽名或蓋章後保管。

#### 第八條：辦理資金貸與他人應注意事項：

- 一、本公司將公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本作業管理辦法之規定，併同評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。
- 二、本公司與子公司間，或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。  
一定額度，除符合第二條第一項第三款規定外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。
- 三、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。
- 四、本公司因情事變更，致貸與對象不符本辦法規定或貸與餘額超限時，財會部門應訂定改善計畫，將相關改善計畫送審計委員會，並依計畫時程完成改善。
- 五、承辦人員應於每月 10 日以前編制上月份資金貸與明細表，逐級呈請核閱。

#### 第九條：對子公司資金貸與他人之控管程序

- 一、本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定本辦法並依本辦法辦理；惟淨值係以子公司淨值為計算基準。
- 二、子公司應於每月 10 日(不含)以前編制上月份資金貸與其他公司明細表，並呈閱本公司。
- 三、子公司內部稽核人員亦應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交審計委員會。

本資料內容為智晶光電專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用。

The content of document is the exclusive property of WiseChip Semiconductor Inc. and shall not be distributed or reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of WiseChip Semiconductor Inc.



四、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事長。

第十條：資訊公開

一、本公司應於每月 10 日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站。

二、本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：

(一)本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。

(二)本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。

(三)本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

(四)本辦法所稱事實發生日，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定資金貸與對象及金額之日等日期孰前者。

三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。

四、本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。

第十一條：罰則

本公司之經理人及主辦人員違反本辦法時，依照本公司工作規則及績效考核辦法提報考核，依其情節輕重處罰。

第十二條：實施與修訂

本辦法應經審計委員會同意，再由董事會通過，並提報股東會同意後實施。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議送審計委員會備查，修訂時亦同。

審計委員會訂定或修正本辦法時應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會同意。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

前項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。

第十三條：附則

本辦法訂定於中華民國一〇〇年六月十七日。

第一次修訂於中華民國一〇二年六月二十四日。

第二次修訂於中華民國一〇八年六月二十四日。

第三次修訂於中華民國一〇九年六月二十二日。



# 智晶光電股份有限公司

## 背書保證作業辦法

### 第一條：訂定依據及目的

本公司有關背書保證事項均依本作業之規定施行之，如有未盡事宜，另依相關法令之規定辦理。

### 第二條：本作業所稱背書保證之範圍及內容如下

#### 一、融資背書保證：

(一)客票貼現融資。

(二)為他公司之融資目的所為之背書或保證。

(三)為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

二、關稅背書保證，係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

三、其他背書保證，係指無法歸類列入前二項之背書或保證事項。

四、公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦應依本作業規定辦理。

### 第三條：本公司所稱背書保證之對象，應符合下列條件

一、與本公司有業務往來關係之公司。

二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

四、本公司與本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。

五、公司因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。前項所稱出資，係指公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。

### 第四條：本公司對外背書保證之額度限制

一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十。

二、本公司對單一企業背書保證額度以不超過當期淨值百分之二十為限。惟對海外單一聯屬公司則以不超過當期淨值百分之四十為限。

三、如因業務關係從事背書保證者，則不得超過最近一年度與本公司交易之總額（雙方間進貨或銷貨金額孰高者）。

四、本公司及子公司整體背書保證總額：以不超過本公司當期淨值之百分之四十為限。

五、本公司及子公司整體對單一企業背書保證限額：以不超過本公司當期淨值之百分之二十為限。

前五項淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。

### 第五條：決策及授權層級

本資料內容為智晶光電專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用。

The content of document is the exclusive property of WiseChip Semiconductor Inc. and shall not be distributed or reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of WiseChip Semiconductor Inc.



- 一、本公司所為背書保證事項，超出保證額度當期淨值百分之二十以上，應先經過董事會決議通過後始得為之，而在當期淨值百分之二十以內，授權董事長核准，事後再報經最近期之董事會追認。但重大之背書保證，應依相關規定經審計委員會同意，並提董事會決議。
- 二、本公司辦理背書保證因業務需要，而有超過本辦法所訂額度之必要且符合本辦法所訂條件者，應經審計委員會同意後送董事會決議並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正本辦法，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。
- 三、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司間為背書保證前，並應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。

#### 第六條：背書保證辦理程序

- 一、被背書保證企業需使用額度內之背書保證金額時，應提供基本資料及財務資料，並填具申請書向本公司財會部門提出申請，財會部門應詳加評估，並辦理徵信工作。  
評估項目包括：背書保證之必要性及合理性、背書保證對象之徵信及風險評估、對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響、應否取得擔保品及擔保品之評估價值。
- 二、本公司財會部門經辦人員將前項相關資料及評估結果彙整，送董事會核定，並依據董事會決議辦理。
- 三、財會部門所建立之背書保證登記表，應就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長執行日期、背書保證日期、依本規定應審慎評估之事項、擔保品內容及其評估價值以及解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。
- 四、被背書保證企業還款時，應將還款之資料照會本公司，以便解除本公司保證之責任，並登載於背書保證登記表上。
- 五、背書票據如因債務清償或展期換新而須解除時，被保證公司應備文將原背書本票送交本公司財會部門加蓋『註銷』印章後退回，來文則列檔備查。在票據展期換新時，若金融機構要求先出具背書新票據再退回舊票據，財會部門應作跟催記錄，追回舊票。
- 六、財會部門應定期評估並認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供簽證會計師相關資料，以供會計師採行必要查核程序，出具允當之查核報告。
- 七、本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本辦法第三條規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第四條所訂額度時，則稽核單位應督促財會部門對於該對象所背書保證之金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送審計委員會並依計畫時程完成改善，以及報告於董事會。

本資料內容為智晶光電專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用。

The content of document is the exclusive property of WiseChip Semiconductor Inc. and shall not be distributed or reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of WiseChip Semiconductor Inc.



八、背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應訂定續後相關管控措施。

子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項第八款規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。

#### 第七條：印鑑章保管及程序

一、背書保證之專用印鑑章為向經濟部申請登記之公司印章，該印章應由董事會同意之專人保管，且與負責辦理背書保證事項者不為同一人，變更時亦同。

二、辦理背書保證時應依公司規定作業程序始得用印或簽發票據。

三、本公司若對國外公司為保證行為時，公司所出具保證函應由董事會授權之人簽署。

#### 第八條：應公告申報之時限及內容

一、本辦法所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會證券期貨局(以下簡稱證期局)指定之資訊申報網站。

二、本公司應於每月 10 日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。

三、本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：

(一)本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。

(二)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。

(三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、採用權益法之投資帳面金額及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。

(四)本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

(五)本辦法所稱事實發生日，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定背書保證對象及金額之日等日期孰前者。

本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。

#### 第九條：對子公司辦理背書保證之控管程序

一、本公司之子公司若擬為他人背書保證者，亦應訂定本作業辦法並依本作業辦法辦理，並需經子公司董事會通過，交子公司監察人且提報子公司股東會，修正時亦同；惟淨值係以子公司淨值為計算基準。

二、子公司應於每月 10 日(不含)以前編制上月份為他人背書保證明細表，並呈閱本公司。



- 三、子公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交審計委員會。
- 四、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人背書保證作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事長。

第十條：內部稽核

本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。

第十一條：罰責

本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時，根據本公司工作規則及績效考核辦法提報考核，依其情節輕重處罰。

第十二條：實施與修訂

一、本公司『背書保證作業辦法』應經審計委員會同意，再由董事會通過，並提報股東會同意後實施。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議送審計委員會備查，修正時亦同。

二、審計委員會訂定或修正『背書保證作業辦法』應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會同意。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

前項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。

第十三條：附則

本辦法訂定於中華民國一〇〇年六月十七日。

第一次修訂於中華民國一〇二年六月二十四日。

第二次修訂於中華民國一〇四年三月二十六日。

第三次修訂於中華民國一〇八年六月二十四日。

第四次修訂於中華民國一〇九年六月二十二日。